创耀(苏州)通信科技股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管 问询函的回复公告

(內各的與來注: 在即用江中乃起江田以及可認為日平月上。 风险提示: 公司接入阿网络芯片与晶圆销售业务收入下滑的风险: 2023年度, 公司接入阿网络芯片与晶圆销 售业务实现收入 29,310.12 万元, 同比下滑 57.24%, 主要原因系受下游客户需求减少导致部分芯片渠 道商采购额下降所致。 如果未来公司接入阿网络芯片与晶圆销售业务下游客户需求仍未回暖, 接入 网芯片产能受限,市场竞争加剧或者公司在短期内末能开拓新的渠道客户,将会对公司的接入网网络

网心方产能交限, 市场竞争加剧或者公司任短期内不能升指新的渠道各户, 将会对公司的接入网网络 芯片与晶圆销售业务的经营业绩造成重大不利影响。 前五大客户变动的风险: 2022-2023年, 公司向前五大客户的销售金额占营业收入比重分别为 8731%, 69.99%, 占比有所下降, 主要系接入网面络芯片与晶圆销售业务部分渠道商销售金额和占比 下降所致。公司向前五大客户的销售由比较高, 如果未来公司主要客户的经营、深龄远路发生变化、 或者因公司自身原因或市场原因导致主要客户的销售金额继续下滑, 可能导致公司的前五大客户发 生产品。探知达到一种经营业,还将还将进入工程经营。

京者因公司自身原因或市场原因导致主要客户的销售金额继续下落,可能导致公司的前五大客户发生变动、将对公司的经营业绩稳定性产生不利影响。
计提存货跌价准备的风险。2023年末、公司存货账面价值为11.611.01万元。同比下降10.55%、公司2023年计捷存货跌价损失1,738.53 万元、主要系。2023年度公司接入网下游客户采购WiFi5 晶圆需求下降所致。公司存货主要由原材料、库存商品。委托加工物资等构成、账面价值相对较高,如果未来交到公司产品市场供需情况发生较大变化。库存产品积压等不和影响。且公司不能加强生产计划管理和存货管理,公司将面临计提存货跌价准备的风险,从而对公司的未来经营产生不利影响。创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月4日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的(关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称"公司"),是2023年年度报告的信息披露监管问询函》(上证料创公函[2024]0148号)(以下简称"问询函")。根据《问询函》要求、公司与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构"),中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中们下"实"审会计师")对(问询函》)所提及的事项进行了逐项核查、落实、现将(问询函》)所涉及的问题回复如下:在下述相关问题的回复中,若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异,均为四舍五人所致。

在下25日内入2003年度公司营业收入 66,110.52 万元,同比下滑 29.05%;归母净利润 5,843.92 万元,年报显示,2023年度公司营业收入 66,110.52 万元,同比下滑 29.05%;归母净利润 5,843.92 万元,年报显示,2023年度公司营业收入 8户销售额 46,269.94 万元,同比下降 43.52%,占年度销售总额 46,269.94 万元,同比下降 43.52%,占年度销售总额 年报显示。2023 年度公司营业收入 66,110.52 力元。同比下層 79,05%;1246平利用 3,844,342 力元。 同比下層 35,80%。其中,本期前五大客户销售额 62,699 45 元。同比下降 43,52%,占年度销售总额 比例由 87,91%下降至 69,99%。请公司:(1)以表格方式列示不同细分产品的营业收入,变化幅度以及 毛利率情况。如有细分产品收入下滑 30%以上的、请结合行业趋势、公司经营以及上下游变化等情 况、补充说明相关产品业域市滑的原因及合理性、与同行业可比公司变化趋势是否一致。如不一致、 请说明原因;(2)补充披露前五大客户情况。说明客户集中度发生变化的原因及合理性。并给令前至及 第50万万元以1、4个17元成瞬间立不各户简心,说明客户集中度发生变化的原因及合理性,并结合前五名客户的变化情况,说明公司主营业务是否发生变化以及是否存在大客户流失的风险。如是,请充分提示风险。

(二)以表格方式列示不同细分产品的营业收入、变化幅度以及毛利率情况。如有细分产品收入下原30%以上的,请结合行业趋势、公司经营以及上下游变化等情况,补充该明相关产品业绩下滑的原因及合理性,与同行业可比公司变化趋势是否一致。如不一致,请说明原因 1,以表格方式列示不同细分产品的营业收入、变化幅度以及毛利率情况 003年度,公司发生的企业是地域上、毛利率及场内的全年率也转发现有工

2023年度 単位:万元		3分产品管	图业收入	、毛利率及特	交2022年	受动情0	动下:		
		2023年度			2022年度			收入占比	毛利率变
业务构成	收人金额 (万元)	占比	毛利率	收入金额 (万元)	占比	毛利率	动情况	变动情况	动情况
通信芯片与解 决方案业务	55,236.33	83.55%	34.00%	84,124.32	90.29%	29.65%	- 34.34%	下 降 6.74 个百分点	上 升 4.35 个百分点
技术开发服务	15,270.32	23.10%	50.75%	4,776.57	5.13%	78.65%	219.69%	上 升 17.97 个百分点	下降 27.90 个百分点
芯片及晶圆销 售	39,823.05	60.24%	27.69%	76,643.98	82.26%	27.05%	- 48.04%	下降 22.02 个百分点	上 升 0.64 个百分点
终端设备销售	142.96	0.22%	2.21%	2,703.78	2.90%	16.76%	- 94.71%	下 降 2.68 个百分点	下降 14.55 个百分点
芯片版图设计 服务及其他技 术服务	10,874.19	16.45%	20.44%	9,048.37	9.71%	18.07%	20.18%	上 升 6.74 个百分点	上 升 2.37 个百分点
其他技术服务	166.81	0.25%	66.06%	11.91	0.01%	25.12%	1, 300.44%	上 升 0.24 个百分点	上 升 40.94 个百分点
芯片版图设计 服务	10,707.39	16.20%	19.73%	9,036.46	9.70%	18.06%	18.49%	上 升 6.50 个百分点	上 升 1.67 个百分点
合计	66,110.52	100.00%	31.77%	93,172.70	100.00%	28.53%	- 29.05%	-	上 升 3.24 个百分点

2022-2023年,公司营业收入由93.172.70万元下降至66.110.52万元,同比减少27.062.17万元,下降幅度29.05%,从产品大类来看,主要系公司通信芯片与解决方案业务的收入下降所致,2023年受下游案户需求影响,芯片及晶圆销售业务和终端设备销售业务收入较2022年分别下降了48.04%和94.71%。与此同时,技术开发服务、芯片版图设计服务及其他技术服务业务板块收入较2022年均有所增长,增长率分别为219%率至108%。
2. 如有细分产品收入下滑30%以上的,请结合行业趋势,公司经营以及上下游变化等情况,补充说明相关产品业统下滑的原因及合理性,与同行业可比公司变化趋势是否一致。如不一致,请说明原因

2023年度,营业收入下降幅度超过30%以上的细分产品情况如下:

	2023年度			2	022年度		收入变	5 收入占比	王利來亦
业务构成	收人金额 (万元)	占比	毛利率	收人金额 (万元)	占比	毛利率	动情况	变动情况 下降 6.74 个百分点 下降 22.02 个百分点	动情况
通信芯片与解 决方案业务	55,236.33	83.55%	34.00%	84,124.32	90.29%	29.65%	-34.34%		上 升 4.35 个百分点
芯片及晶圆销 售	39,823.05	60.24%	27.69%	76,643.98	82.26%	27.05%	-48.04%	下降 22.02 个百分点	上 升 0.64 个百分点
终端设备销售	142.96	0.22%	2.21%	2,703.78	2.90%	16.76%	-94.71%	下 降 2.68 个百分点	下 降 14.55 个 百分点
从上表可	以看出,20	023年度常	雪业收入	下降幅度超	过30%以	人上的细:	分产品为	通信芯片与	解决方案

业务中的芯片及晶圆销售和终端设备销售业务,上述细分产品的收入下降直接导致了通信芯片与解 业分平的心力及面圆销音杯经验设置销音业分,工处组为厂证 决方案业务整体收入的下降,进而导致了公司营业收入的下降。 (1)芯片及晶圆销售业务 公司基片及晶圆销售业务的主要产品系由力线费油通信类

(1)芯片及品剧销售业务的主要产品系电力线载波通信芯片、模组及相关量产服务、VSPM340及 VSPM350芯片等型号的接入网网络芯片及WiFi5 AP、WiFi6 AP、网关芯片、转发芯片等接入网芯片所用的品剧。 公司销售的电力线载波通信芯片、模组及量产服务主要应用于智能电网用电信息采集领域、客户

公司销售的电力线载波通信芯片、模组及量产服务主要应用于智能电周用电信息采集领域、客户 为国家电阅、南方电阅等 LPULC 方案提供商。此外,公司模块可应用于智慧悠灯和光伏通信领域。 公司销售的接入网芯片主要应用于海外通信设备市场及6 山、智慧城市等应用场景、2023年度 公司接入网芯片销售业务的客户主要为芯片贸易商、通信设备及解决方案商。公司接入网品圆销售 业务面向的客户为深圳市达新供应营机限公司,西安意业电子科技有限责任公司等中广互联指定的 芯片渠道商(以下简称"芯片渠道商")、依据2021年1月公司子公司重庆创皖和中广互联签署的(芯 片技术使用段权合同)、公司后续须向中广互联指定客户提供批量供应 WiFi 芯片或晶圆、最终生产组 装后形成无线路由器等的经通信设备对外销售。 报告期内、公司芯片及晶圆销售业务按不同用途分为电力线载波芯片相关和接入网芯片相关,各 用途下的产品销售收入及对应芯片及晶圆销售收入占比情况如下: 单位:75元

		2023年度	2022年度		
产品类别	收人金额	占芯片及晶圆销售业务收 入的比重	收人金额	占芯片及晶圆销售业务 收入的比重	
电力线载波芯片、模组 及量产服务	10,512.93	26.40%	8,101.19	10.57%	
接人网网络芯片及晶 圆	29,310.12	73.60%	68,542.79	89.43%	
合计	39,823.05	100.00%	76,643.98	100.00%	

(平四)13%。 公司销售的接人网网络芯片及晶圆属于通信芯片行业,其中VSPM340,VSPM350及WiFi AP芯片 主要竞争对手为联发料、瑞昱等台湾省通信芯片厂商及博通、高通等海外通信芯片厂商,国内无同类 竞争对手。因此以乐叠科技、钢捷科技、原希通信三家。很及从事WiFi IoT芯片和WiFi FEM研发与销 情的厂商及联发料、瑞县等者名通信芯片厂商公开披露数据进行对比

盲印》 同汉权汉个	1、桐立守有石旭旧心///	同公月1及踏致机伍过1	MILL:
可比公司	对应业务板块	对应收入增长率	对应毛利率增长率
乐鑫科技	芯片业务	34.84%	下降 0.43 个百分点
翱捷科技	芯片业务	25.17%	下降11.82 个 百分点
康希通信	Wi-Fi FEM	-7.03%	下降1.12个百分点
联发科	营业收入【注】	-21.63%	下降1.52个百分点
瑞昱	营业收入【注】	-15.10%	下降6.06个百分点
创耀科技	接人网网络芯片及晶圆销售	-57.24%	下降2.75个百分点
注:因联发科	、瑞昱未披露 Wi-Fi 芯片』	2务收入、毛利率情况,	故以营业收入情况进行对比。

注:因联发料、瑞昆未披露Wi-Fi芯片业务收入,毛利率情况、成以营业收入情况进行对比。 从上表可以看出,受市场环境影响、公司及可比公司对应业务毛利率均有所下滑、公司毛利率变 动与同行业公司具有一致性。公司收入变化情况与康希通信、联发料、瑞昱相同、但与乐鑫科技、朝捷 科技变化不同,主要系公司WiFi AP芯片应用于运营商市场、朝捷科技与乐鑫科技的WiFi IoT芯片主 要应用于物联网及便携式通信终端,产品性能及应用领域与公司不完全可比所致。 从收入变化需度来看。公司接入网相关的芯片及晶圆销售业务收入下滑幅度高于同行业其他公司,主要系下游客户需求变动所致。公司 2022年度、2023年度芯片及晶圆销售业务的五大客户及收 1 株区以来设计程记任。

	2023年度	
客户名称	销售金额	占芯片及晶圆销售业务的比重
深圳市达新供应链有限公司	7,884.78	19.80%
西安磊业电子科技有限责任公司	6,662.94	16.73%
芯蕊(珠海)科技有限责任公司	3,791.59	9.52%
客户B	3,568.53	8.96%
西安浩源电子科技有限公司	3,214.01	8.07%
合计	25,121.85	63.08%
	2022年度	
客户名称	销售金额	占芯片及晶圆销售业务的比重
西安磊业电子科技有限责任公司	41,820.62	54.56%
深圳市达新供应链有限公司	21,962.15	28.65%
西安浩源电子科技有限公司	2,639.34	3.44%
晟芯科技孵化器江苏有限公司	1,886.84	2.46%
POWER-STAR ELECTRONICS CO.LIMITED	70.63	0.09%
合计	68,379.58	89.22%

从客户收入构成情况来看,2022年度西安磊业电子科技有限责任公司和深圳市达新供应链有限 公司采购金额较大,占芯片及品圆销售业务收入的比重分别为54.56%。28.65%。是芯片及品圆销售业务收入的土重分别为54.56%。28.65%。是芯片及品圆销售业务收入的主要构成。2023年度由于西安磊业电子科技有限责任公司、深圳市达新供应链有限公司采购额下降。经公司业务人员确认,更安磊业电子科查程限责任公司、深圳市达新供应链有限公司采购额下降主要系由于2023年之前芯片产能较为紧张、客 2备货数量较多,后续客户在去库存的过程中,采购需求下降导致公司芯片及晶圆销售业务收入大幅

条上,公司芯片及晶圆销售业务营业收入变动系受下游客户需求导致部分芯片渠道商采购额下降所致,公司芯片及晶圆销售业务毛利率变化与同行业可比公司对应业务毛利率变化趋势一致,具有

(2)终端设备销售业务
公司销售的接入网络端设备为有线接人的路由器,主要用于海外通信市场,采购方为英国电信,
2023年度公司终端设备销售业务实现收入142.96万元,占公司总营收比例为0.22%,同比下降
94.71%,主要系炎司与英国电信需求下降并与公司合作终止所致。此外,2023年度该业务毛利率下降14.55
个百分点,主要系公司与英国电信合作终止、公司对刺纳终端设备接行"尾单促销处理"导致毛利率水平校低,未来公司终端设备将不再销售。
综上、线端设备销售业务营业收入变动系受英国电信需求下降所致,毛利率变化系尾单促销所致,具有合理性,未来公司终端设备将不再销售。终端设备销售业务2023年营业收入142.96万元,占公司总营收比例为0.22%,该业务板块的变动对公司的经营影响较小。
(二)补充披露前五大客户情况,说明客户集中度发生变化的原因及合理性,并结合前五名客户的变化情况,说明公司主营业务是否发生变化以及是否存在大客户流失的风险。如是,请充分提示风险。

1、补充披露前五大客户情况2022年度公司前五大客户销售情况如下:

单位:万元	- 11HI TT / C4	37) THE	HDCXII I	•				
		2023年度		2022年度		销售金额		
客户名称	销售内容	销售金额	营业收 入占比	销售金额	营业收 入占比	变动幅度	发生变动的情况	
公司A及关联公司	芯片版图 设计服务、 技术开发 服务	16,444.04	24.87%	8,433.82	9.05%	94.98%	系公司技术开发服务和芯片版 图设计客户,主要系公司提供 的DSL长周期技术开发服务项 目验收,该项目收人金额较大 导致销售金额上升	
西安磊业电子科技 有限责任公司及其 关联方【注】	WiFi5、 WiFi6晶圆	14,497.66	21.93%	45,015.29	43.81%	-67.79%	系公司芯片及晶圆销售客户, 受下游客户需求下降导致销售 金额下降	
深圳市达新供应链 有限公司	WiFi5、 WiFi6晶圆	7,884.78	11.93%	21,962.15	23.57%	-64.10%	系公司芯片及晶圆销售客户, 受下游客户需求下降导致销售 金额下降	
客户B	WiFi6晶圆	3,756.75	5.68%	-	-	100.00%	新增芯片及晶圆销售客户	
深圳市中广物联科 技有限公司	技术授权	3,686.71	5.58%	2,792.95	3.00%	32.00%	系技术开发服务客户,公司提供按授权期间的摊销确认的芯片授权许可,其中一项芯片授权于2022年9月起开始确认收入	
会计		46.269.94	69.99%	81.916.54	83.93%	-43.52%	_	

合计 | 46,269.94 | 69.99% | 81,916.54 | 83.93% | -43.52% | - 注:西安磊业电子科技有限责任公司及其关联方包含西安磊业电子科技有限责任公司、西安浩源电子科技有限公司和达赛(珠海科技有限责任公司、 2.说明宏户集中度发生变化的原因及合理性从前五大客户营业收入占比从87.91%下降至69.99%、从前五大客户占比情况来看、公司2023年度前五大客户营业收入占比从87.91%下降至69.99%、经工业企工上处专证工程、土理客市投资机由工经批步度提供。

前五大客户占比有所下降,主要系西安磊业电子科技有限责任公司及其关联方和深圳市达新供应链有限公司销售金额和占比均有所下降所致,具体下降原因参见本回复之"一、(一)2、(1)芯片及晶圆销

售业务"部分回复的内容。 因此。2023年度公司前五大客户集中度下降主要系中广互联指定芯片渠道商西安磊业电子科技有限责任公司及其关联方和深圳市达新供应链有限公司需求下降所致。 3.结合前五名客户的变化情况,说明公司主营业务是否发生变化以及是否存在大客户流失的风险。如是,请充分提示风险 2023年度公司前五大客户销售变化情况表及原因参见本回复之"一、(二)1、补充披露前五大客户

情况"。从上表可以看出,受下游客户需求影响。2023年度公司部分客户销售金额有所作,公司经营情况稳定,主营业务未发生变化。截至本回复出具日,公司与相关客户合作正常,不存在大客户流失

2.大丁以本及毛利率。 年报显示、成本构成中,封测成本2,627.22 万元,同比增长56.23%;直接人工3,566.60 万元,同比增长333.8%。同时、2022、2023 年公司销售收入毛利率分别是28.53%和31.77%,2023 年度同比增加3.24 个百分点,产品销售业务收入规模下降而毛利率增长。请公司:(1)将主营业务按照细分产品

进行拆分,逐项列示各细分产品近三年的营业收入、营业成本及毛利率并分析变动原因;(2)结合公司 生产的具体方式和同行业可比上市公司对比情况,分析成本构成以及各项成本归集,结转的方法和过程,并结合公司产品销售业务收入变化趋势,分析毛利率增加的原因及合理性,是否符合行业趋势。

、公司回复 ·)将主营业务按照细分产品进行拆分,逐项列示各细分产品近三年的营业收入、营业成本及毛 2021年-2023年,公司各细分产品的营业收入、营业成本及毛利率情况如下:

->+ FT N6 301	2023年度				2022年度			2021年度	
产品类型	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
通信芯片与解 决方案业务	55,236.33	36,457.65	34.00%	84,124.32	59,180.81	29.65%	55,744.86	38,101.07	31.65%
技术开发服务	15,270.32	7,519.99	50.75%	4,776.57	1,019.98	78.65%	6,385.59	398.07	93.77%
芯片及晶圆销 售	39,823.05	28,797.86	27.69%	76,643.98	55,910.16	27.05%	45,541.23	34,521.00	24.20%
终端设备销售	142.96	139.80	2.21%	2,703.78	2,250.67	16.76%	3,818.04	3,181.99	16.66%
芯片版图设计 服务及其他技 术服务	10,874.19	8,651.51	20.44%	9,048.37	7,413.78	18.07%	8,321.37	6,893.00	17.17%
其他技术服务	166.81	56.62	66.06%	11.91	8.92	25.12%	41.37	40.55	1.99%
芯片版图设计 服务	10,707.39	8,594.89	19.73%	9,036.46	7,404.86	18.06%	8,279.99	6,852.46	17.24%
总计	66,110.52	45,109,16	31.77%	93,172.70	66,594.59	28.53%	64,066.23	44.994.07	29.77%

2021年-2023年,公司通信芯片与解决方案业务的营业收入、营业成本及毛利率情况如下:

単位:刀兀									
か口袋用	2023年度				2022年度		2021年度		
产品类型 技术开发服务 芯片及晶圆销售 终端设备销售	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
技术开发服务	15,270.32	7,519.99	50.75%	4,776.57	1,019.98	78.65%	6,385.59	398.07	93.77%
芯片及晶圆销 售	39,823.05	28,797.86	27.69%	76,643.98	55,910.16	27.05%	45,541.23	34,521.00	24.20%
终端设备销售	142.96	139.80	2.21%	2,703.78	2,250.67	16.76%	3,818.04	3,181.99	16.66%
通信芯片与解 决方案业务	55,236.33	36,457.65	34.00%	84,124.32	59,180.81	29.65%	55,744.86	38,101.07	31.65%
2021年-2									
和55,236.33万	元,2023年	E度营业收	入大幅	「降。 营业	:成本分别	为38,101	.07万元、	59,180.81	万元和36,

和52,29.33 万元,2023年度當业收入大職下降。當业收入方利为 88,1010 7万元,39,180.81 万元和36,457.65 万元,营业成本储蓄收入规模的变化亦相应变动。
2021年-2023年,公司通信芯片与解决方案业务的综合毛利率为31,65%、29,65%和34,00%、毛利率相对稳定、2023年通信芯片与解决方案业务的综合毛利率有所上升,主要系不同毛利率水平的产品收入结构变化所变、毛利率相对较高的技术开发服务收入金额和占比上升、毛利率相对较低的芯片及晶圆销售,终端设备销售收入和占比下降,综合导致公司 2023年年度接入网网络芯片及解决方案业

1年-2023年,公司技术开发服务收入,成本及毛利率变化情况如下;

单位:万元			
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	15,270.32	4,776.57	6,385.59
营业成本	7,519.99	1,019.98	398.07
毛利率	50.75%	78.65%	93.77%
	司技术开发服务收入分别		
	为公司 A、德国电信等通		
6。技术开发服务受开5	台计划、客户验收等综合因	素影响,以项目最终客户	验收作为技术开发服务等

商, 技术开发服务受开发计划,客户验收等综合因素影响,以项目最终客户验收作为技术开发服务实现客户交付的时间点,2023年公司营业收入相对较高,主要系公司向公司 A提供的DSL技术开发项目通过给收所致,该项目开发周期按长,启动于2020年1月,于2023年11月验收,项目金额较大。
2021年-2023年,公司技术开发服务业务毛利率分别为93.77%、78.65%和50.75%、2022年、2023年毛利率有所下滑,主要系①2022年、2023年部分技术开发项目需向客户交付样品,因此成本中包含流片费,导致成本支出较高。毛利率水平按低;20203年验收的 DSL技术开发项目周期按长,人员工资较高,且成本中包含流片费、IP费,导致该项目毛利率较低;30202年、2023年由于双模电力线载波通信芯片的技术开发难度较高,耗费人力较大,导致相关人员成本较高。

2021年-2023年,公司芯片及晶圆销售收入、成本及毛利率变化情况如下:

项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	39,823.05	76,643.98	45,541.23
营业成本	28,797.86	55,910.16	34,521.00
毛利率	27.69%	27.05%	24.20%
2021年-2023年,公	司接人网网络通信芯片与	晶圆销售收入分别为45,5	41.23万元、76,643.98万元

2021 中-2023年,公司按人與明治則言心戶与面與用語收入分別为45.541.23 万元,76.643.98 万元 和39.823.65 万元,2021 年产023 年该业务收入金额较高,毛利率相对稳定,2023 年度芯片及晶圆销售 收入下滑主要系接入网相关客户西安部业电子科技有限责任公司,深圳市达新优应辖有限公司受下 游公司需求下降影响导致当年采购额减少,具体分析参见本回复之第一题"一、(一)2、(1)芯片及晶圆 经银业者"现入日营化中达" 主业务"部分回复的内容。 (3)终端设备销售 2021年—2022年 公司终端设备销售收入、成本及毛利率变化情况如下

单位:万元	内 经熵仅任用告收入、0X4	· 及七利辛变化同00如下:	
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	142.96	2,703.78	3,818.04
营业成本	139.80	2,250.67	3,181.99
毛利率	2.21%	16.76%	16.66%
2021年-2023年、公	司接人网网络诵信终端边	设备销售收入分别为3.81	8.04万元、2.703.78万元和

142.96万元,2021年-2023年该业务的客户为英国电信,销售收入及毛利率波动主要由于与英国电信 合作终止及尾单促销影响所致,未来公司终端设备将不再销售,具体分析参见本回复之第一题" (一)2、(2)终端设备销售业务"部分回复的内容。

2021年-2023年,公司芯片版图设计及其他技术服务的营业收入、营业成本及毛利率情况如下:

Γ	产品类型	2023年度				2022年度		2021年度		
) 109692	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	
Γ	其他技术服务	166.81	56.62	66.06%	11.91	8.92	25.12%	41.37	40.55	1.99%
	芯片版图设计 服务	10,707.39	8,594.89	19.73%	9,036.46	7,404.86	18.06%	8,279.99	6,852.46	17.24%
	芯片版图设计 服务及其他技 术服务	10,874.19	8,651.51	20.44%	9,048.37	7,413.78	18.07%	8,321.37	6,893.00	17.17%

本服务 2021年-2023年,公司芯片版图设计及其他技术服务的营业收入分别为8.321.37万元,9.048.37万元和10.874.19万元,营业收入维持增长的趋势,复合增长率为14.31%;营业成本分别为6.893.00万元,7.413.78万元和8.651.51万元,营业成本随着收入规模的变化亦相应变动。 2021年-2023年、公司芯片版图设计及其他技术服务的综合毛和率为17.17%、18.07%和20.44%, 毛利率保持相对稳定略有上升,主要系公司逐渐拓展非大客户业务,该业务毛利率较高。

2021年-2023年,公司其他技术服务收入、成本及毛利率变化情况如下:

项目	2023年度	2022年度	2021年度			
营业收入	166.81	11.91	41.37			
营业成本	56.62	8.92	40.55			
毛利率	66.06%	25.12%	1.99%			
2021年-2023年,公司其他技术服务收入分别为41.37万元、11.91万元和166.81万元,该业务主要						
向客户提供芯片相关的技术咨询及测试服务,该业务整体规模较小、收入占比较低,毛利率情况主						

要受具体项目收费、人员成本影响。 2021年-2023年,公司芯片版图设计服务收入、成本及毛利率变化情况如下:

十つロン・フリフロ						
项目	2023年度	2022年度	2021年度			
营业收入	10,707.39	9,036.46	8,279.99			
营业成本	8,594.89	7,404.86	6,852.46			
毛利率	19.73%	18.06%	17.24%			
2021年-2023年,公	司芯片版图设计服务收入	分别为8,279.99万元、9,0	036.46万元和10,707.39万			
元,营业收入及毛利率整体保持稳定,略有小幅增长,公司芯片版图设计服务主要是向客户提供芯片						
版图规划、设计实现、版图	B验证等服务,可以提高容	户研发效率,降低流片失	败的风险。公司芯片版图			

(1)居官公司上1975年以上 1975年以上 1975年,1975年以上 1975年,1975年以上 1975年,1975年,1975年,1975年,1975年,1975年,1975年

限的方法和过程 (1)通信芯片与解决方案业务 1.主要生产模式 主要业务分为:芯片及晶圆销售、技术开发服务和终端设备销售三部分。

エヌュ・ガルグ: ルコ 及回回は日前 (スペアス版タが中で帰るが円費ニ即が。 対于芯片及周囲销售、公司主要涉及①电力线载波通信芯片、模组及量产服务②接人网网络芯片 及晶圆这 2种产品类型组成。

①所涉及生产模式为:针对电力线载波通信芯片及模组,公司独立完成芯片的全流程设计,将晶 即所涉及生产模式为: 针对电力线载波测信心片及模组,公司独立完成心片的全流使设计,将商圆制造,封装测试及模块加工等环节条托专业的品圆代工及封侧,完成,形成芯片后公司对外销售或委托厂商进行加工。主要成本为晶圆成本,封装测试费、模组加工费和模组所需其他集成电路成本等。针对量产服务,公司在量产阶段向客户提供,P模权,并根据客户需求提供相应环节的量产服务,以提高量产环节效率和产品良率。主要服务模式为根据客户的需求,公司可自多户提供。对接品圆进行品圆制造,b.对接封装厂商完成芯片的封装。公对接测试厂商完成芯片的测试三种服务的任意组合或全部、最终交付芯片产品,生产模式与电力线载波通信芯片业务相同。主要成本为品圆成本,封建删试费等。

装测试费等。
②所涉及生产模式为:接人网芯片系与公司A合作研发完成,WiFi芯片系自主研发,公司采用fables模式,公司在完成集成电路版图的设计后,将版图交予晶圆代工厂商,温圆代工厂商完成晶圆制造形成晶圆。向中广互联指定的芯片渠道商销售,未对外销售的晶面公司委托封装厂,测试厂进行后续工艺加工,最终形成芯片。主要成本为晶圆成本,封装测试费,运费及其他等。对于技术开发服务,公司根据客户的需求及委托,提供通信芯片相关技术开发,技术授权及维保服务,相关成本支出按项目进行核算,技术开发项目,技术授权项目于公司向客户交付样片或技术成果、签客户验收后结转成本,维保服务依据服务,协议按期间结转成本。主要成本为各项目的人工成本,流行费技术授权赞等其他成本。

本、流方實技术技权實等其他放本。 对于终端设备销售,系公司自主设计研发的接人网网络通信终端设备,主要可应用于海外通信市场,客户为英国电信,公司采用OEM的模式,将外采的集成电路、零部件交往委外加工厂商,由委外加工厂商加工完毕后发回公司,公司最终销往英国电信。主要成本为:集成电路费、委外加工费、辅料及 根据公司通信芯片与解决方案的业务生产流程,结合同行业上市公司公开披露信息,对比情况如

业务构成	产品用途	公司生产模式	同行业公司生产模式	是否存在差 异及原因
芯片及晶	电力线载 波通信芯 片相关	针对芯片及模组、公司独立完成芯片 的全流程设计,将高圆制剂 主转装削 试及模块加工等环节委托专业的 圆代工及封测厂完成;针对量产服 多,在量产阶段向客户提供PP模水、 并根据客户需求提供相应环节的量 产服务,以提高量产环节效率和产品 良率	力合微:力合微宽带电力线载波通信 芯片产品主要为自主设计并委托品园 厂商及封规厂商进行生产引自超级 设明书记项股份:期信通讯为其一站 式芯片定制服务的客户,具体包括芯 片设计业务及芯片量产业务[引自招 股说明书]	否
四	接人网芯片相关	公司采用fabless模式,公司在完成集成电路板图的设计后,将版图交子晶圆代工厂商完成层圆制造形成晶圆,向中广互联接定的芯片,完适商销售,未对外销售的品圆由公司委托封装厂,测试了进行行续工艺加工,最终形成芯片。	乐鑫科技, Fables 模式, 即无晶圆厂生产制造, 仅从事集成电路设计的经营模式。 公司集中优势资源用于产品研技、设计环节, 只从事集成电路的时发、设计和销售, 生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。	否
技术开发服务	-	对于技术开发服务,公司根据客户的 需求及委托,提供接入网相关技术开 发,技术更仅及维保服务,相关成本 互出按项目直对合构象,技术成本 互由按项目直对公司增零产空付 特许成技术成果,径客产增验位标 成本,维保服务依据服务协议按期间 结转成本	志原胚份,为客户提供以下过程中的 部分或全套服务。即根据客户对芯片 都小部分或全部服务,即根据客户对芯片在方面、排入了发成本等方法 在 可能,实进行下关项及验证,实实现及验证,实实现及验证,实实现是实现,实现是实现,实现是实现,是 对于 一种 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性	否
终端设备	-	公司自主设计研发的接入网网络通信终端设备、公司采用OEM的模式, 将外采的集成电路、零部件交往委外 加工厂商,由委外加工厂商加工完毕 后发回公司	共进股份:主要以ODM/JDM模式为主 (同时覆盖OEM,EMS等各种代工模式),为国内外知名通信设备提供商和 电信运营商提供宽带通信终端以及数 据通信终端产品研发、生产和服务	否

综上可见,公司通信芯片与解决方案业务生产模式与同行业上市公司不存在差异。 III. 分析成本构成以及各项成本归集。结转的方法和过程 通信芯片与解决方案成本归集。结转方法和过程如下:

a.nsvn 村木则八库 公司生产部门向晶圆厂商下达晶圆采购订单,订单对采购晶圆的品种、价格、结算方法、交货方 质量标准等均有约定。晶圆厂根据公司采购订单完成晶圆加工、公司对不同规格、型号的晶圆均 置了单独的物料代码,对于检测合格的晶圆,作为原材料以采购成本人账。 b. 委外封装测试

b. 安下對表例IX 公司生产的根据生产计划向封测厂下达封测订单,封测厂对指定批次的晶圆进行封装及测试、 财务部门在 ERP 系统亲人封装领用原材料数量、金额及型号等信息并归集至相关订单,月末系统完成 原材料到委外加工物资的转移。 c.产成品(芯片及量产服务)人库

。 一次四个次配,据为八年 封測「完成封装和削试后,公司通知封測厂将成品发往客户指定地点。月末系统将委托加工物 资成本加上封测费,计算整颗芯片的成本,并完成委托加工物资到产成品的成本结转。

d.安外组装加工 公司生产部门根据生产计划向模组加工厂下达委托加工订单,加工厂根据委托加工单数量接收 立数量的芯片及代采模组所需的PCB电路板,财务部门在ERP系统录入芯片出库数量、金额及 型号等信息并归集至相关订单,完成原材料到委外加工物资的转移。 2021年-2023年,公司芯片及晶圆业务成本构成情况如下:

		AY HADDAN L.	
单位:万元			
成本构成	2023年度	2022年度	2021年度
品圆	25,095.40	53,009.11	32,475.00
集成电路	921.59	1,077.32	1,020.79
封装	2,174.21	1,305.93	722.47
測试	453.00	375.69	244.80
运费及其他	113.07	95.52	33.76
加工费	40.59	46.59	24.18
合计	28,797.86	55,910.16	34,521.00

公司员工通过工时管理软件记录其参与项目工时情况,月末部门负责人审批员工考勤记录,财务

人员统计员工工时数据,并按工时比重核算员工工资、社保等费用分配至对应项目的开发服务成本。 b. 其他费用 页目执行过程中发生的流片费、IP授权费及员工发生的差旅费、办公费等其他相关费用在发生当

2021年-2023年,公 单位:万元	可仅小开友服务成-4构成	育优如下:	
成本构成	2023年度	2022年度	2021年度
直接人工	3,566.61	822.60	244.81
其他	3,953.38	197.38	153.26
合计	7.519.99	1.019.98	398.07

公司生产部厂根据生产计划采购主芯片等核心部件发货至外协加工厂、并通过外协加工厂采购 其他电子元器件等辅料、原材料由外协加工厂人库后以采购成本人账。 b. <u>象外生产</u>

公司生产部门根据生产计划向外协加工厂下达生产订单,月末系统按生产领用原材料数量完成原材料到委托加工物资的转移。

科到發生加工物效的转移。 6.产成品人库 外协加工厂完成订单生产后,公司通知外协加工厂将终端设备发往客户指定地点。月末公司按 产品数量将委托加工物资成本加上加工费,计算产成品的成本,完成委托加工物资到产成品的成 产品数量将委托加工物资成本加上加工费,计算产成品的成本,完成委托加工物资到产成品的成 本结转。 2021年-2023年,公司终端设备销售业务成本构成情况如下:

单位:万元	OKANOKE IN ELEZAKAT	-9/4/19/00/47 .	
成本构成	2023年度	2022年度	2021年度
集成电路	64.58	1,078.36	1,501.14
其他电子元器件及辅料	45.97	791.08	1,069.62
加工费	11.29	204.43	308.79
运费	17.96	176.79	302.44
合计	139.80	2,250.67	3,181.99

(2)芯片版图设计及其他技术服务

务,成图设订理局需要限制规划,设订关项。成图验证中和成图元成等逻辑。具体服务内各包括第二乙语 件性能测试版图设计,模块版图设计。走芯片版图设计。全芯片版图设计项目管理,版图设计指导、芯 片版图设计环境搭建。版图设计工具软件维护、脚本设计规则编写。版图设计验证交付管理流程建立 和优化。版图相关专利设计等。公司根据客户版图设计需求工作量、技术难度问客户定期收取服务 费。主要成本为人工成本、差旅费及其他费用。 其他技术服务;主要为公司基于自有核心技术及设计能力,在非电力线载波通信及接入网领域开 展的技术开发或技术支持服务等。主要成本为人工成本、差旅费和其他费用。 11. 同行业上市公司对比情况

根据公司芯片版图设计和其他技术服务流程,结合同行业上市公司公开披露信息,对比情况如

业务构成	公司生产模式	同行业公司生产模式	是否存在差异及原因
芯片版图设 计服务	根据客户的实际枢图设计需求公司 就胜相应的极少 孔视师结束版图设 计报务、版图设计通常需要版图级 引设计字规,级图验证和版图完成 等步骤、具体服务内容包括新工艺器 等步骤、具体服务内容包括新工艺器 等步骤、具体服务内容包括新工艺器 等步骤、具体服务内容包括新工艺的 均可自管理、原图设计指导、芯片板图设计 均面与型形成器建立和优化、版图设计 最近交付管理流程建立和优化、板图设计 器设计常束工作量、按木堆度向客户 定称使加多序。	洞和软件,软件技术服务主要依托公司力 在云、边端侧师积累的核心技术能力, 这种效实力,这些一个整体通过设计 第二云计算等产业大客户提供系统软件 设置,还计算等产业大客户提供系统软件 发展转货中投、整贴货件投。 间间两个任王修等研发项目的技术服 务。软件技术服务包括研发用整包 和人力技术服务两种交付模式。	否
其他技术服 务	主要为公司基于自有核心技术及设计能力,在非电力线载波通信及接入 网领域开展的技术开发或技术支持 服务等		否

综上可见,公司芯片版图设计与其他技术服务业务生产模式与同行业上市公司不存在差异。 III.分析成本构成以及各项成本归集、结转的方法和过程 芯片版图设计服务及其他技术服务业务成本归集、结转方法和过程如下: ①芯片版图设计服务

a.直接人工成本 公司员工通过工时管理软件记录其参与项目工时情况,月末部门负责人审批员工考勤记录,财务 人员统计员工工时数据,并按工时比重核算员工工资、社保等费用分配至对应项目的开发服务成本。 项目执行过程中员工发生的差旅费、办公费等其他相关费用在发生当期归集至项目服务成本。

2021年-2023年,公司芯片版图设计服务成本构成情况如下: 单位:万元								
成本构成	2023年度	2022年度	2021年度					
直接人工	8,446.33	7,273.73	6,666.44					
其他	148.56	131.13	186.02					
合计	8,594.89	7,404.86	6,852.46					

②其他技术服务

。直接人工成本 公司员工通过工时管理软件记录其参与项目工时情况,月末部门负责人审批员工考勤记录,财务 人员统计员工工时数据,并按工时比重核算员工工资,社保等费用分配至对应项目的开发服务成本。 加克兰岛州 项目执行过程中员工发生的差旅费、办公费等其他相关费用在发生当期归集至项目服务成本。 2021年-2023年,公司其他技术服务成本构成情况如下:

56.62 8.89 36.79 直接人 2、结合公司产品销售业务收入变化趋势,分析毛利率增加的原因及合理性, 2022年、2023年,公司各业务板块营业收入、收入占比及其毛利率情况如下:

	2023年度				2022年度				综合毛利
业务构成	收入金額 (万元)	占比	毛利率	综合毛利 率贡献率 【注】	收入金額 (万元)	占比	毛利率	综合毛利 率贡献率 【注】	宗 字 一 一 本 一 献 率 一 数 情 况
通信芯片与解 决方案业务	55,236.33	83.55%	34.00%	28.40%	84,124.32	90.29%	29.65%	26.77%	增加 1.63 个百分点
技术开发服务	15,270.32	23.10%	50.75%	11.72%	4,776.57	5.13%	78.65%	4.03%	増加 7.69 个百分点
芯片及晶圆销 售	39,823.05	60.24%	27.69%	16.68%	76,643.98	82.26%	27.05%	22.25%	减少 5.57 个百分点
终端设备销售	142.96	0.22%	2.21%	0.00%	2,703.78	2.90%	16.76%	0.49%	减少 0.49 个百分点
芯片版图设计 服务及其他技 术服务	10,874.19	16.45%	20.44%	3.36%	9,048.37	9.71%	18.07%	1.75%	増加 1.61 个百分点
其他技术服务	166.81	0.25%	66.06%	0.17%	11.91	0.01%	25.12%	0.00%	增加 0.17 个百分点
芯片版图设计 服务	10,707.39	16.20%	19.73%	3.20%	9,036.46	9.70%	18.06%	1.75%	増加 1.45 个百分点
合计	66,110.52	100.00%	31.77%	31.77%	93,172.70	100.00%	28.53%	28.53%	増加 3.24 个百分点

注:综合毛利率贡献率=毛利率*收入占比 各业务板块收入及毛利率变动情况及具体原因参见本回复第二题之"一、(一)将主营业务按照细

各业务板块收入及毛利率变对情况及具体原因参见本回复第三题之"一、(一)将主营业务按照细分产品进行转分,逐项列产名细产产品近三年的营业收入、营业成本及毛利率并分析变效原则。由上表可以看出,2023年公司综合毛利率从28.53%上升至31.77%,主要系公司不同毛利率水平的业务板块收入结构变化所致。2023年毛利率较简的通信芯片与解决方案业务技术开发服务收入占比提高;进而导致住货产毛利率贷献率增长所致。通信芯片与解决方案业务技术开发服务收入占比提高主要有两方面导致;一方面是公司向公司 A提供的形式技术开发项目于2023年验收,该项目金额较大;另一方面是电力线载波通信市场由单模 向双模切换,促使了客户的委托开发的需求。随着2022年第四季度国家电网启动双模电力线载波通信模组(以下简称"双模PLC")集采计划以来,原本参与国家电网集团和风景地分线被选通信模组(以下简称"双模PLC")集采计划以来,原本参与国家电网集工机

来,原本参与国家电阅集采的PLC 方案提供商陆操启动双模 PLC 研发设计,公司凭借在PLC 领域的技术 获积累和在双模 PLC 上的先发优势,积累了多项政模 PLC相关的技术储备,各国家电网 PLC 方案提供 商为缩短研发周期,提升产品质量,抢占双模 PLC 市场,纷纷委托公司提供技术开发服务,导致技术开 商为缩短研发周期、提升产品质量、抢占双模PLC市场、纷纷委托公司提供技术升发服务、导致技术升发服务收入规模的提升。 单模PLC向双模PLC切换的趋势亦可从同行业上市公司力合微2023年年度报告看到,力合微电 力物联网业务板块营业收入较2022年上升了14.18%,其自志片营业收入上升了457.01%,其披露自主芯片营业收入处营业成本增加主要系本期双模芯片销售大幅增长所致。 综上、2023年公司综合毛利率提升系因双模PLC行业需求提升、DSL技术开发项目交付使得2023

年通信芯片与解决方案业务中的技术开发服务收入占比上升及毛利率贡献率提升所致,与行业需求 3.关于预付款项。 3.关于预付款项。 年报显示,公司期末预付款项54,645.84万元,较上年末增长67.36%。前五名预付对象合计期末 索额54,545.29万元,占比99.81%。请公司;(1)补充前五名预付对象名称、金额,付款时间,是否系关 联方,具体采购内容,付款及交货安排等;(2)结合经营需求、商业惯例等,说明营业收入下滑的同时预 付款项大幅增长的原因及合理性。

(一)补充前五名预付对象名称、金额、付款时间、是否系关联方、具体采购内容、付款及交货安排 截至2023年末,公司前五名预付对象合计期末余额为54,545.29万元,占比99.81%。公司前五名预付对象具体情况如下表所示:

付款时间 合同金额(含 对应预付款 销售订 具体采购 是否 项(万元) 取(万元) 单覆盖 内容 关联) 669.70 2021年 58,653.06 芯国际及其关联 2022年 36,942.86 9,690.60 38,330.07 57,445.14 2022年 8,001.80 3,920.05 已部分到货,其余担双方认可的交货进度 海灏谷集成日 技术有限公司 2023年 70.74 70.74 公司A 2023年 2,120.00 1,166.00 0.00% 技术许 已部分到货,其余拍 双方认可的交货进 芯集成电路 (厦门)有限公司 2023年 573.28 464.82 67.95% 晶圆代 海嘉筠通信技术

(二)结合经营需求、商业惯例等、说明营业收入下滑的同时预付款项大幅增长的原因及合理性公司是一家专业的集成电路设计企业,主要采用 Fables 经营模式,在该模式下、公司主要负责各类通信芯片的设计和销售、温励制造,共类制式等不分别多托专业的品圆厂而和封侧厂商完成。该情形下、公司无需进行大量固定资产投资,可以集中力量专注于芯片产品和相关技术场所发,从而能够更好地响应市场需求,开发更多符合市场需要的新产品,提高研发效率和运营的灵活性,同时有效条低大规模固定资产投资所带来的财务风险。但另一方面、公司的经营也会受到上游温圆厂商的品圆代工价格、产能情况。交付周期等带来的不确定性的影响。由于晶圆厂商产能有限、芯片市场需求较大、芯片设计企业与晶圆厂商产资工等以来受品圆代工价格下降影响。晶圆代工价格需求有所增加,晶圆厂商产低量的工作。公司为保证客户订单的及时执行、选择最简与出海晶圆厂商签案采购订单、从而提前领定晶圆厂商的净保证客户订单的及时执行、选择最简与自由温圆厂商签案采购订单、从而提前领定晶圆厂商的净产设产了单的及时执行、选择最简与由游晶圆厂商签署采购订单、从而提前领定晶圆厂商的产帐、保证之货房则稳定。公司于2023年10月至2023年12月初的公司主要供应商中达国际及其关联方支付了23,091,31万元条项的对该项大幅增长、采购预付款、因此、虽然公司2023年官业收入下滑、但公司为了领定上游晶圆厂商产能提前产单、导致公司预付款项大幅增长、采购预付款支付的具体情况详见本向询回复第三题之一、(一)"补充前五名预付对象名称、金额(付款时间、是否系关联方、具体采购内容、付款及交货安排等"。

4.关于存货。 年报显示,公司存货账面价值为11,611.01万元,同比下降10.55%,本期计提存货跌价损失1, 738.53万元。其中原材料期来顺金常湖 416.47万元,存货账价准备计提比例为10.64%。高于去年的 2.90%;库存商品期末账面余额 4.738.98 万元,存货账价准备计提比例为 28.17%,大幅高于去年的 2.90%;库存商品期末账面余额 4.738.98 万元,存货账价准备计提比例为 28.17%,大幅高于去年的 2.48%。请公司:(1)列示各类别存货库龄结构;结合公司情况,说明库存商品,发出商品等金额变为是 吞与在手订单匹配;(2)结合在手订单、产品生产周期及更新迭代等情况,说明在毛利率上升的情况下,存货账价准备计提比例提高的原因及合理性。分产品类型披露计提存货账价准备的库存商品内容、库龄等信息,并说明是否存在已被淘汰的产品,是否存在前期减值计提不充分的情形。

(一)列示各类别存货库龄结构,结合公司情况,说明库存商品、发出商品等金额变动是否与在手 列示各类别存货库龄结构

截至2023年12月31日,公司各类别存货库龄结构如下:

期末余粫

154.01

154.01

类别

1年844	DR177 FT	/半行11000	公田同田	安11加工物页	カスラチルス・45	カルキオ・100		
1年以内	3,167.42	1,443.22	154.01	2,919.32	457.58	8,141.55	60.49%	
1-2年	673.08	3,165.84	-	449.85	385.42	4,674.19	34.73%	
2-3年	277.23	65.40	-	60.30	129.95	532.88	3.96%	
3年以上	47.04	64.52	-	-	-	111.56	0.82%	
合 计	4,164.77	4,738.98	154.01	3,429.47	972.95	13,460.18	100.00%	
2023年末,公司存货库龄以1年以内为主,占公司期末存货余额的60.49%,库龄1年以上的存货								
累计占比为39.51%,主要为库存商品、原材料、委托加工物资和服务成本。								
2.结合公司情况,说明库存商品,发出商品等金额变动是否与在手订单匹配								

截至2023年12月31日,公司仅有通信芯片与解决方案业务的芯片及晶圆销售业务结存库存商

期后结转比例

100.00%

100.00%

154.01

154.01

订单覆盖率

100.00%

100.00%

4,738,98 3,667,94 77.40% 5,604,40 118.26% 3.471.27 3 008 80 3,484,92 100.39% 86 68% 2,770.58 其中:WiFi5晶 WiFi6晶圆 24.28 12.69% 3,114.05 12,825.58% 3.08 力线载波通信芯 方案业务产 2,119.48 1,267.71 659.14 51.99% 167.19%

154.01

154.01

小 计 4.892.99 3.821.95 78.11% 5.758.41 117.69% [注 1]期后销售对应结转成本金额为 2024 年 1 月 1 日 − 5 月 3 1 日销售产品对应结转的成本金额 [注 2]在手订单金额 至 2023 年末在手订单列表未发货数量*期末名产品成本单价 注 3 1 订单 電影率 - 在 于订单金额平 6 以明末余额 公司主要采用 Fabless 经营模式,不直接从事晶圆制造,封装测试或其他生产加工工作,晶圆制,封装测试或其他生产加工工作,晶圆制,封装测试或其他生产加工工作,晶圆制,对表测试水域块及系统加工均委托专业的广商完成,公司根据在手订单和市场需求预测制定委托产订划,并根据销售预测上行适当的产品备货以清度销售需求。 2023 年末库存商品订单覆盖率为 118.26%。覆盖率较高、WFi6 晶圆及电力线载波通信芯片与解 7条业条产品即后户生理职系行过度分位,社转转至费业成本。期后持续比例分别为 12.69%。

2023年小序中所而订单度通率为178.20%。 (德無年末高)、外市6面融政生力发表效应自己介于9% 决方案业务产品期后已实现部分订单交付,并结转至营业成本,期后结转让例分别为12.65%。 51.99%。金额变动与在手订单匹配;自2021年6月起,公司向客户西安磊业电子科技有限责任公司、深 圳市达部供应链有股公司销售 Wiris 届圆。为应对客户需求,2020年—2022年度充足备货,但2025年 度接入图下游客户未买购"Wiris 温圆,导致接入网网络芯片与解决方案业务 Wiris 温圆期末库存金额 较高,在手订单金额为1继入网网络芯片与解决方案业务的芯片及其他产品的在手订单覆盖率为 54.83%。期后已实现部分订单交付,并结转至营业成本,期后结转比例为 34.76%。金额变动与在手订

2023年末发出商品的在手订单覆盖率为100,00%。已干期后会部结转至成本,发出商品会额变动 与在手订单匹配。 综上所述,本期未公司库存商品、发出商品的订单覆盖率为117.69%,除通信芯片与解决方案业务的芯片及晶圆销售业务的WiFi5晶圆无在手订单外,其他库存商品、发出商品的期后金额变动与在

为于订单匹配。 (二)结合在手订单、产品生产周期及更新迭代等情况,说明在毛利率上升的情况下,存货跌价准

(二)结合在手订单、产品生产周期及更新迭代等情况、说明在毛利率上升的情况下,存货跌价准备计提比例提高的原因及合理性。分产品类型披露计提存货跌价准备的库存商品内容,库龄等信息,并说明是否存在已被淘汰的产品。是否在前期或值计提不充分的情形。 1.结合在手订单,产品生产周期及更新迭代等情况,说明在毛利率上升的情况下,存货跌价准备针提比例提高的原因及合理性。(1)毛利率变动与存货跌价准备计提比例要或时况分析。2023年度生利率较2022年度有所上升,系毛利率不同的各业务收入占比变化所致。2023年度毛利率较高的通信芯片与解决方案业务的技术开发服务收入占比较2022年度有所上升,进而导致公司2023年度综合毛利率上升。3.24个百分点。具体分析可参见本回复之第三题"一、(二)2.结合公司产品销售业务收入变化趋势、分析毛利率增加的原因及合理性,是否符合行业趋势"的回复。因此、公司综合毛利率的上升系收入结构测整所致、公司各业务线毛利率并非出现用显的提升。中通信芯片与解决方案业务的艺片及温圆销售业务毛利率小幅度上升,但收入占比从2022年度的82.26%下降至60.24%。通信芯片与解决方案业务的终端设备销售业务毛利率外幅度上升,但收入占比从2022年度的82.26%下降至60.24%。通信芯片与解决方案业务的终端设备销售业务毛利率从幅度上升,但收入占比从2022年度的82.26%下降至60.24%。通信芯片与解决方案业务为的终端设备销售业务毛利率大幅度下降、毛利率从2022年度的16.76%下降至60.24%。通信芯片与解决方案业务对应的存货出现或值风险,导致存货跌价准备计提比例提高。

高。此外,公司计提跌价准备的依据是按照期末存货的可变现争值与账面争值孰低来判断,2023年度公司预计可变现争值低于账面价值的存货主要为WiFi5晶圆和G1、G2芯片,上述存货在2023年度未实现销售或销售金额按小,在手订单覆盖率较低,因此对上述存货按照可变现净值低于账面价值的部分计提存货跌价准备。

分计提存货跌价准备。 综上,2023年度公司综合毛利率上升系收入结构调整所致,公司各业务线毛利率并非出现明显的提升,计提跌价准备的存货对应的业务板块毛利率略有上升或大幅度下降,公司结合存货可变现净值和账面价值情况对期末存货计提跌价准备。 (2)公司2022年末,2023年末存货跌价准备计提情况如下表: 单位,万元

中世:万元							
		2023年12月31日	3	2022年12月31日			
项目	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	计提比例(%)	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	计提比例(%	
原材料	4,164.77	443.09	10.64	1,622.56	47.04	2.90	
库存商品	4,738.98	1,334.95	28.17	4,691.73	116.52	2.48	
发出商品	154.01	-	-	121.84	-	-	
委托加工物资	3,429.47	71.13	2.07	2,075.39	-	-	
服务成本	972.95	-	-	4,632.98	-	-	
合 计	13,460.18	1,849.17	13.74	13,144.50	163.56	1.24	
由上書 公司存货 2023 年末全麵鈴 2022 年末增加 315 68 万元 左货贴价准条 2023 年末全麵							

由上表,公司存货 2023年末余额较 2022年末增加 315.68 万元, 存货跌价准备 2023年末余额较 2022年末增加1.685.61 万元。 其中,原材料余额较上期末增加 2.542.21 万元,跌价准备金额较上期增加 396.05 万元,主要系公司通信芯片与解决方案业务的终端设备增售业务已无在手订单, 恆元增售预期,本期将与之相关的原材料全额计提跌价准备,对应跌价准备增加 263.13 万元;通信芯片与解决方案业务的芯片及晶圆销售业务对应的部分原材料库龄较长,跌价准备增加 132.92 万元。 库存商品余额较上期末增加 47.25 万元,跌价准备金额较上期增加 1.218.43 万元,一方面是因为2023年度按人周下游客户未采购 WiFis 晶圆,截至 2023年度在手订单金额为 0. 预计销售可能性较低,于期末计提大额存货跌价准备,期末跌价准备金额为 1.224.49 万元,另一方面是因为市场竞争激烈,产品更新迭代速度较快,部分库龄较长的存货存在被淘汰的可能,按照公司存货跌价政策计提存铁价价值各、期末在货货收价准备条额为 87.52 万元。 為於 同史制度 長跌价准备,期末存货跌价准备金额为87.52万元。 委托加工物资余额按上期末增加,1,354.08万元。跌价准备金额较上期增加71.13万元,主要系因 为通信芯片与解决方案业务的芯片及晶圆销售业务对应的委托加工物资库龄较长或性质不良,全额

计提存货跌价准备,跌价准备增加71.13万元 日 2021年 2022年12年6年 2021年 17.15 月72。 (3)2023年度接入阿下游客户采购WF15 晶圆需求下降,公司存货跌价准备计提增加公司库存商品主要分通信芯片与解决方案业务的芯片及晶圆销售业务产品,2022年 12月31日、2023年 12月31日库存商品分产品类型的金额及在手订单对比情况如下表: 値次,万字

2023年12月31 库存商品类型 账面余额 在手订单金额 账面余额 在手订单金额 1,334.95 116.52 108.05 1,313.51 其中:WiFi5晶圆 2,770.58 1,224.49 2,450.59 WiFi6晶圆 676.41 370.87 89.02 823.47 897.81 108.05 1,267,71 2,119.48 21.44 834.12 8,410.60 8.47 5,604.40 1,334.95 4,691.73

金额=∑2023 ± 自2021年6月起公司向客户西安磊业电子科技有限责任公司、深圳市达新供应链有限公司销例网WiFi5晶圆。2022年度确认收入966.78万元,且期末充足备货,库龄均在一年以内,未出现减低 风险,故2022年末存货跌价准备为0万元;2023年度下游客户采购WiFi5品圆需求下降,且大部分存货库龄超过一年,经销售部门研判,由于市场情况,预计WiFi3品圆预计销售价格扣除相关税费后可达到成本价50%;因此,公司将WiFi3品圆对应的存货按照账面成本的50%计算可变现净值,确认跌价

项目 整面余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 账面价值 账面余额 账面价值 6.22 74.23

61系列芯片、C2系列芯片库龄基本为3年以上,两期存在被淘汰可能的库存商品存货跌价准备 计提方式基本一致,未发生显著变化。 综上所述、2023年度公司综合毛利率上升,但通信芯片与解决方案业务的芯片及晶圆销售业务、 终端设备销售业务业务毛利率略有上升或大幅度下降,部分晶圆产品和终端设备的在手订单未增长、 部分芯片型号老旧,存在被淘汰的可能,导致存货跌价准备计提比例上升,整体存货跌价准备计提比例由2022年末的1.24%提高至2023年末的13.74%。 2.分产品类型披露计提存货款价准备的库存商品内容,库龄等信息,并说明是否存在已被淘汰的 产品,是否存在前期减值计提不充分的情形 (1)分产品类型披露计提存货跌价准备的库存商品内容,库龄等信息 2023年12月31日库存商品按产品类型、库龄统计如下: 单位、万元

2022年12月31日库存商品按产品类型、库龄统计如下:

单位:万元							
项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	账面余额	存货跌价准备	账面价值
一、通信芯片与解决方 案业务的芯片及晶圆 销售业务	1,443.22	3,165.84	65.40	64.52	4,738.98	1,334.95	3,404.03
电力线载波通信芯片 与解决方案业务	814.74	439.53	4.77	8.67	1,267.71	21.44	1,246.27
其中:基于IP授权的量 产服务	743.67	439.53	4.77	6.93	1,194.90	19.69	1,175.21
芯片及模块	71.07	-	-	1.74	72.81	1.75	71.06
接人网网络芯片与解 决方案业务	628.48	2,726.31	60.63	55.85	3,471.27	1,313.51	2,157.76
其中:WiFi5晶圆	321.60	2,448.98	-	-	2,770.58	1,224.49	1,546.09
WiFi6晶圆	3.08	21.20	-	-	24.28	-	24.28
芯片	303.80	256.13	60.63	55.85	676.41	89.02	587.39
小计	1,443.22	3,165.84	65.40	64.52	4,738.98	1,334.95	3,404.03
按库龄统计库存商品 占比	30.45%	66.80%	1.38%	1.36%	100.00%		
存货跌价准备	22.94	1,242.37	5.36	64.28		1,334.95	
存货跌价准备计提比	1.59%	39.24%	8.20%	99.63%		28.17%	

单位:万元 4,366.73 207.52 3.19 114.30 4.691.7 116.52 4.575.22 . 力线载波通信芯 与解决方案业务 812,45 12.09 3.09 6.50 834.13 825,66 812.45 12.09 2.30 4.63 831.47 5.81 825.66 接人网网络芯片与解 决方案业务 0.10 107.80 195.43 3,554.28 108.05 其中:WiFi5晶圆 2,450.59 2,450.59 2,450.59 WiFi6晶圆 195.43 0.10 107.80 520.14 4,366.73 207.52 3.19 114.30 4,691.74 116.52 4,575.22 库龄统计库存商品 93.07% 4.42% 0.07% 2.44% 0.39 1.97 114.16

(2)并说明是否存在已被淘汰的产品,是否存在前期减值计提不充分的情形

2.48%

0.19% 61.81% 99.87%

3.如后心门一种大力率近为第2.0万年,但是那么15天人,就主要2.5年12.75年,几十年 此的产品主要为通信芯片与解决方案业务的芯片及温圆销售业务的产品 后。系列芯片、C2系 参见本题"(二)1、(4)芯片行业产品更新迭代较快,库存商品中部分芯片产品存在被淘汰的

能"的回复。
2)公司各期存货跌价准备计提宏分、不存在前期或值计提不充分的情形
2022年末及2023年末。存货采用成本与可变现净值源低计量,其中:
a)产成品,商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去后的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。该产负债表日,同时间转换完成。在证常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本。估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。资产负债表日,可项贷货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的。分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较。分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2022年末公司库存商品库龄为1年以内、1-2年、2-3年、3年以上的占比分别为93.07%、4.42%、2022年、公司库存商品库龄为1年以内、1-2年、2-3年、3年以上的占比分别为93.07%、4.42%、0.07%、2.44%、对应驶价准备计提比例为0.00%、0.19%、61.81%、99.87%。库存商品跌价准备计提比例为0.00%、0.19%、61.81%、99.87%。库存商品跌价准备计提比例为2.48%。公司存货周转率较高、其中2年以内的库存商品、未出现明显呆滞或性面不良等减值风险,期已根据随价值与可变现净值公间的差额计提存货款价准备,因此股价准备计提比例数分。

可变现净值为零、公司对该部分库存商品全额计提了跌价。 2023年末公司库存商品库龄为1年以内、1-2年、2-3年、3年以上的占比分别为30.45%、66.80%。 2023年来公司库存商品库融为 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上的占比分别为 30.45%、66.80%、1.36%、对应股价准备计提比例为 1.59%、39.24%。8.20%、99.63%、库存商品跌价准备计提比例为 1.59%、39.24%。8.20%、99.63%、库存商品跌价准备计提比例为 1.59%、39.24%。8.20%、99.63%、库存商品跌价准备计提比例 1828.17%、2023年未除参为 1.2年的库存商品占比大幅度提高,对应股价准备计提比例类的更提高、该库存商品主要为 WiFi 5 品圆 由于下游客户采购接入网 WiFi 5品圆需求下降且 2023年度未实现销售,截至 2023年未公司无 WiFi 5 在手订单、根据销售部门反馈、后续销售存在困难。公司按照预估可变现净值确认跌价准备 1.224.49 万元。经公司确小人WiFi 5 品圆对应存货已于近期实现销售,销售价格高于公司预计的可变现净值金额。综上所定、2022年度公司综合为该存货成本高于可变现净值的差额,库龄、预计未来可使用状态及呆滞情况等因素,按照存货跌价政策、计提了充分的跌价准备、不存在前期底值计提不充分的情形;2023年度受下游客户采购需求下降,导致出现呆滞情况、跌价准备金额大幅度增加。5、关于无形资产。年报显示、公司无形资产账面价值(6.471.52 万元、同比下看48.11%。公司无形资产主要由软件和技术许可和成、账面价值分别为 521.64 万元和5.949.88 万元、其中、技术许可本助计提牌销6.971.84 万元,计提比例约为 43%、较上年提升12 个百分点。请公司结合无形资产结构、用途、摊销的会计政策等,说明公司无形资产账面价值大幅下滑的原因及合理性。一、公司回复

一、公司回复 公司无形资产由软件和技术许可构成,主要用于研发项目、服务项目以及办公,摊销期限根据合同约定使用期限和结合市场情况预期使用寿命孰低确定。 公司无形资产结构、用途、摊销的会计政策等情况列示如下:

单位:	万元						
结构	摊销的会计政 策	用途	2023 年账面价 值	2023 年 占比	2022 年账面价 值	2022年占比	变动比例
软件	3-10年	研发项目	490.42	7.58%	195.52	1.57%	150.83%
	3-10年	办公	31.22	0.48%	36.31	0.29%	-14.02%
	小计		521.64	8.06%	231.83	1.86%	125.01%
技术许可	1-10年	研发项目	5,942.97	91.84%	12,196.87	97.79%	-51.27%
	3年	服务项目	2.78	0.04%	27.78	0.22%	-89.99%
	3年	办公	4.13	0.06%	15.96	0.13%	-74.12%
	小 计		5,949.88	91.94%	12,240.61	98.14%	-51.39%
V 7T			(471 52	100.000	10.470.44	100.000	40.1107